



# 華景電通股份有限公司

Brilliant Network & Automation Integrated System Co., Ltd.

## 2020年法人說明會



Brilliant  
Network & Automation  
華景電通

2020年10月

# 免責聲明

本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。華景電通股份有限公司（本公司）並不負有更  
新或修正本簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之  
資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、  
或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的  
完整論述。

# Agenda

公司概況

01

市場概況

03

經營實績

05

02

產品介紹

04

研發技術

# 公司概況



- 成立日期: 89 年 9 月 7 日
- 實收股本: 新台幣 3.16 億元
- 總公司: 廣源科技園區-苗栗縣竹南鎮科義街41號
- 子公司: 芯物聯位於上海花橋市、樂玩位於台灣苗栗縣
- 員工人數: 總公司 129 人; 芯物聯約 35 人; 樂玩 12 人

- 主要產品：
  - A. 晶圓製程AMC防治設備
  - B. RFID整合派工系統
  - C. 其他



# 關聯企業圖



# 公司沿革



**2000**  
公司創立

**2009**

·總公司遷至新竹縣寶山鄉  
·台南設立辦事處

**2011**  
設立子公司昆山芯物聯電  
子通訊有限公司

**2015**

華景產品“晶圓傳載盒充氣監控製程設備”  
導入16nm 晶圓代工製程且良率大幅拉升，  
榮獲主要客戶優良廠商獎



# 公司沿革



2016

- 總公司移至竹南鎮廣源科技園區
- 台中設立辦事處



2017

·通過ISO9001認證

- 取得台灣發明專利“具有吹淨功能的晶圓傳送裝置”
- 取得台灣發明專利“晶圓充氣負載平台的控制方法”
- 取得德國專利 Beladungsöffnungsanschluss mit

2018

高階製程微汙染防治傳載系統  
取得美國發明專利“PURGE LOAD PORT”



2019

設立子公司樂玩實業(股)公司



2020

# 企業願景

**「華」** 巍願 **「景」** ， **「電」** 馳融 **「通」** 。

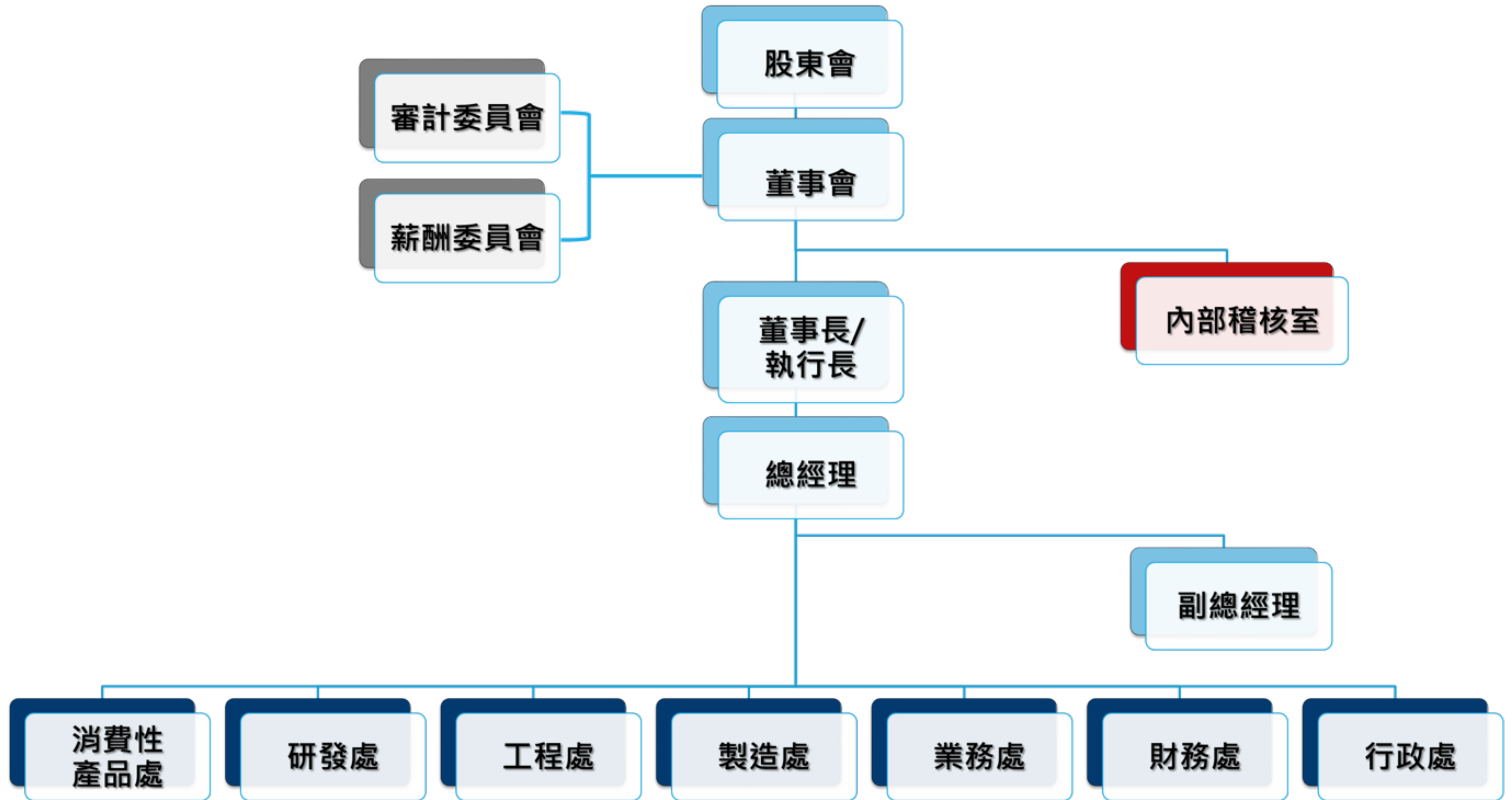
我們致力於改善客戶整體生產力，是客戶提升生產力的最佳夥伴。

華景電通藉由整合「網路通訊技術」與「自動化技術」，提供客戶創新的「生產力」改善解決方案，以有效地提升客戶的「生產力」，並同時提高客戶資本回報率與營運績效。這也是華景電通立業的願景使命與價值創造之所在。

Make client productivity brilliant through innovative network & automation solutions.



# 組織結構



# 董事會成員



職稱	名稱	學歷	主要經歷
董事長	樂豆實業有限公司 法人代表人陳榮華	明新科技大學 電子工程科	台灣積體電路製造(股)公司工程師 世大積體電路(股)公司工程師 華邦電子(股)公司工程師
董事	吉宣投資(股)公司 法人代表人高新明	台灣大學國際企業管 理組碩士	帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長
董事	金豆事業有限公司 法人代表人陳榮坤	逢甲大學紡織系	台灣積體電路製造(股)公司副理
董事	羅宏輝	中原大學物理學系	台灣積體電路製造(股)公司工程師
董事	廖鴻文	中央大學資管系碩士	龍騰光電(股)公司自動化部部經理 台灣積體電路製造(股)公司副理
董事	簡豐杰	新民商工職業學校	茂鉅工程科技有限公司董事長 瑞昌彩藝(股)公司董事

# 董事會成員



職稱	名稱	學歷	主要經歷
獨立董事	張裕富	成功大學電機工程學系	新唐科技(股)公司副總經理 華邦電子(股)公司記憶產品晶圓製造中心協理
獨立董事	王丕承	美國明尼蘇達大學應用統計博士	長庚大學工商系教授 財團法人科政中心主任 中央大學工業管理系教授 中央大學管理學院院長
獨立董事	趙榮祥	臺灣大學商學所碩士	台塑勝高科技(股)公司副總經理 台塑公司專員

# 經營團隊

職稱	姓名	學歷	主要經歷
董事長/執行長	陳榮華	明新科技大學 電子工程科	台灣積體電路製造(股)公司工程師 世大積體電路(股)公司工程師 華邦電子(股)公司工程師
總經理	羅宏輝	中原大學物理學系	台灣積體電路製造(股)公司工程師
副總經理兼財務 長	王淑芳	元智大學管理研究所	家登精密(股)公司 財務處長 南俊國際股份有限公司財會經理 友嘉集團子公司財會經理
子公司總經理	廖鴻文	中央大學資管系碩士	龍騰光電(股)公司自動化部部經理 台灣積體電路製造(股)公司副理
業務處處長	古震維	台北科技大學 機電科技研究所博士	家登精密(股)公司 研發專案經理

職稱	姓名	學歷	主要經歷
消費性產品處 處長	程櫻森	明新科技大學 資訊管理學系	誠加科技(股)公司 副理 慧群環境科技(股)公司 專案工程師
製造處處長	管恩虎	親民工專電子工程科	將富建設(股)公司 銷售專員 冠軍建材(股)公司 特助
研發處副處長	吳耀宗	大葉大學 自動化工程學系碩士	聯發科技(股)公司 資深工程師
稽核處長	黃曉莉	清華大學經營管理碩士	竹陞科技(股)公司 財務長 聚積科技(股)公司 子公司經理 資誠聯合會計師事務所 領組



1 承諾(Commitment)

2 創新(Innovation)

3 分享(Sharing)

# Agenda

公司概況

01

02

產品介紹

市場概況

03

04

研發技術

經營實績

05

# 優質客戶群



Brilliant is close proximity to its customers for collaboration and access to services

Multi-market drivers and increasing chip demand are driving Brilliant's continued growth

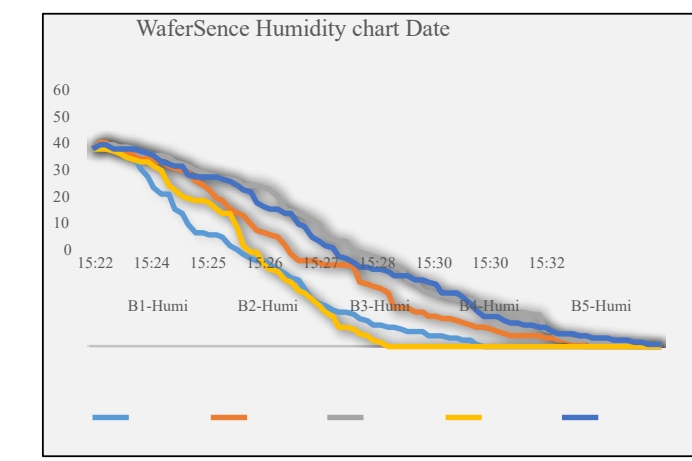
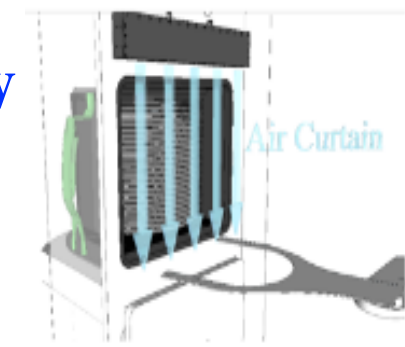
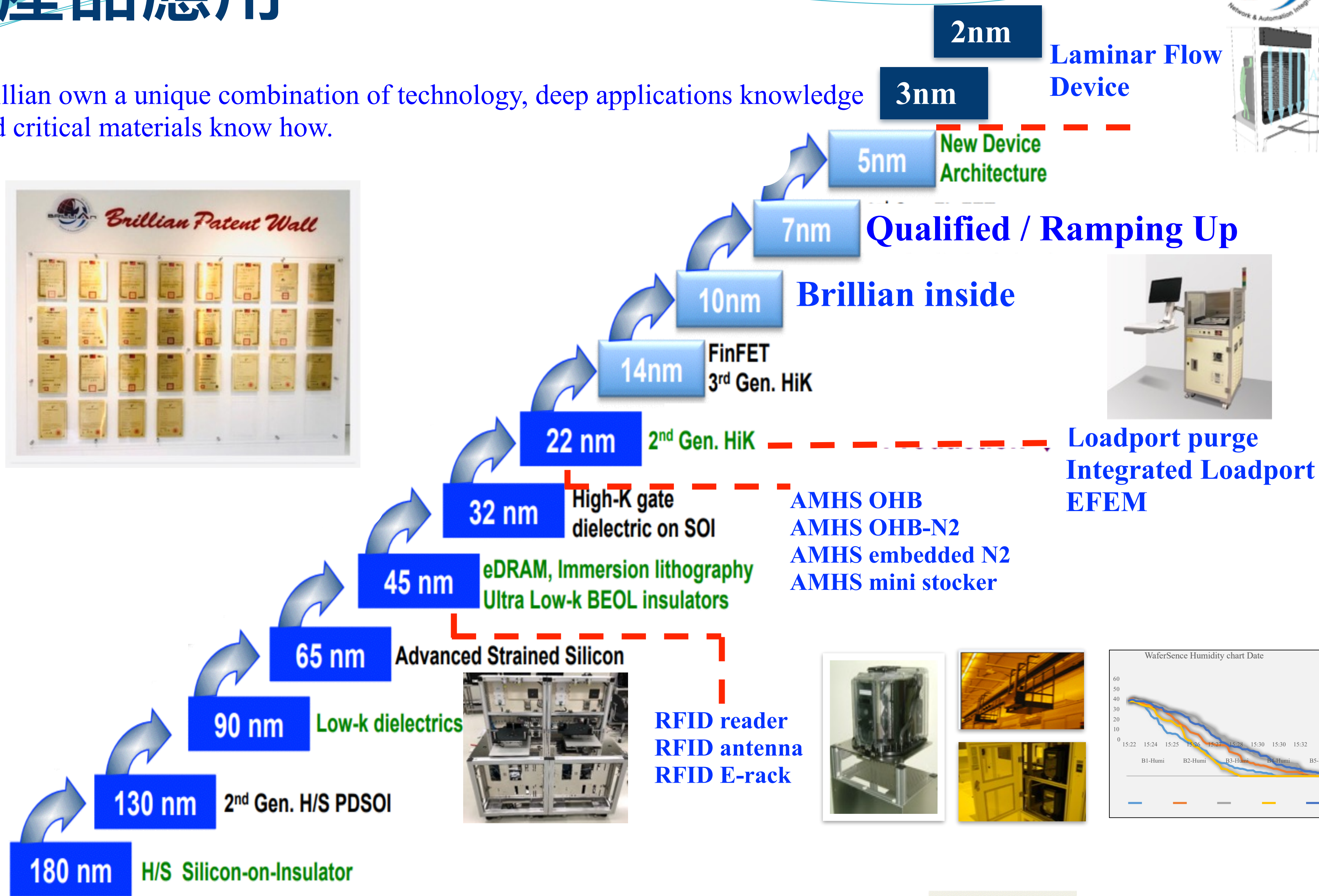




# 產品應用



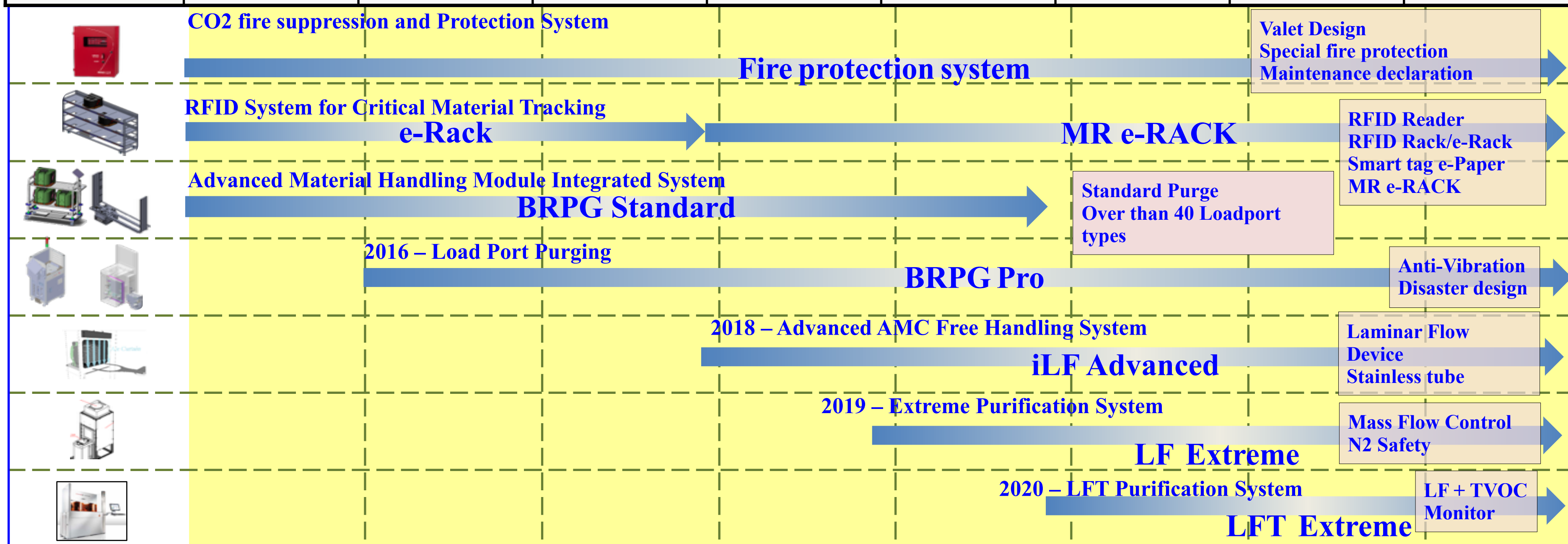
Brilliant own a unique combination of technology, deep applications knowledge and critical materials know how.



# 產品沿革



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2024
Logic Foundry	20/16nm		12nm	10nm	7nm	5nm	3nm	2nm
Logic MPU	22nm	14nm	10nm		7nm	5nm	3nm	2nm
DRAM	20-22	1X		1Y		1Z	Next	
Flash	32L	48L		64L	92L	128/136L	15X/17XL	



## 晶圓製程AMC防治設備

先進材料傳載整合管理監控系統

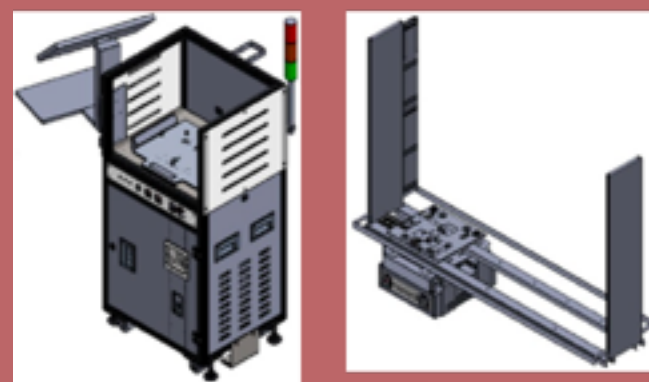
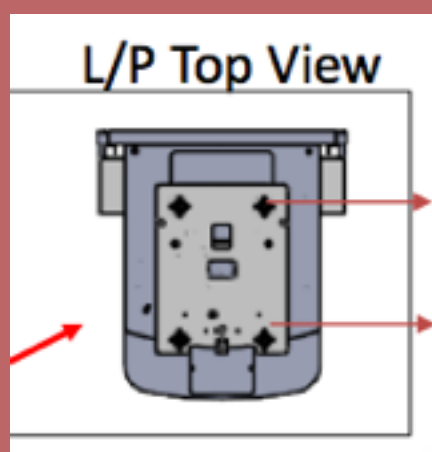
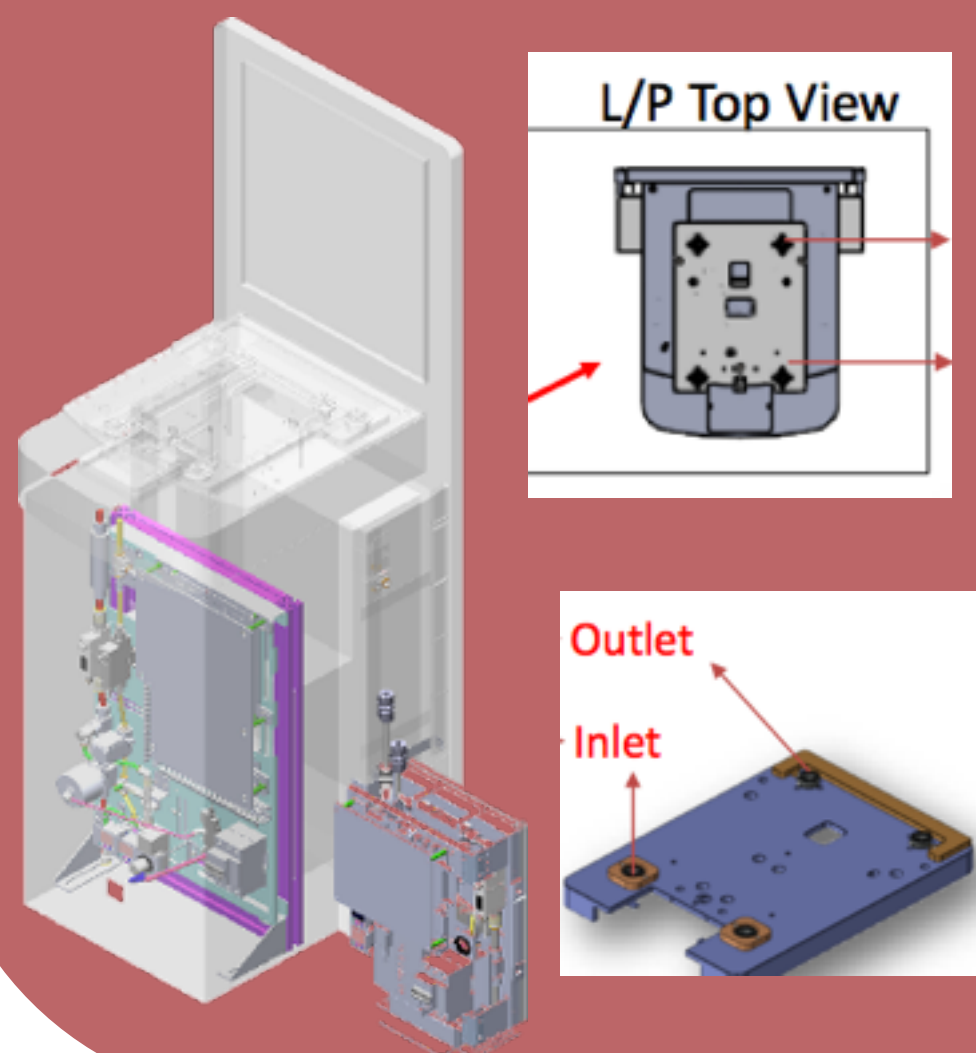
高階製程微汙染防治傳載系統

FOUP Purification/AMC Free

Lordport purge  
Integrated Lordport EFEM

Materials Handling

AMHS  
OHB/UTS-N2  
Stocker/Embedded N2

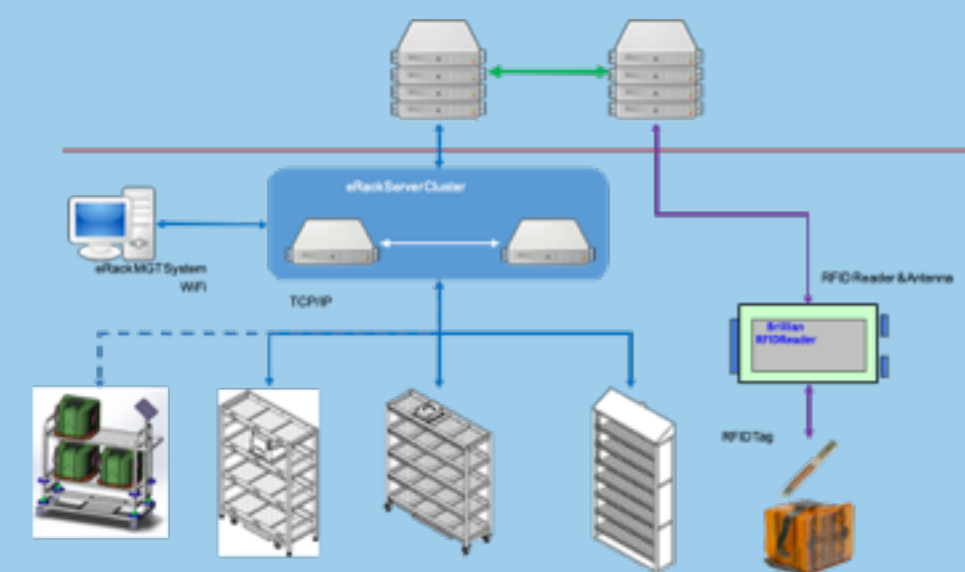


## RFID整合派工系統

關鍵材料傳載追蹤識別管理系統

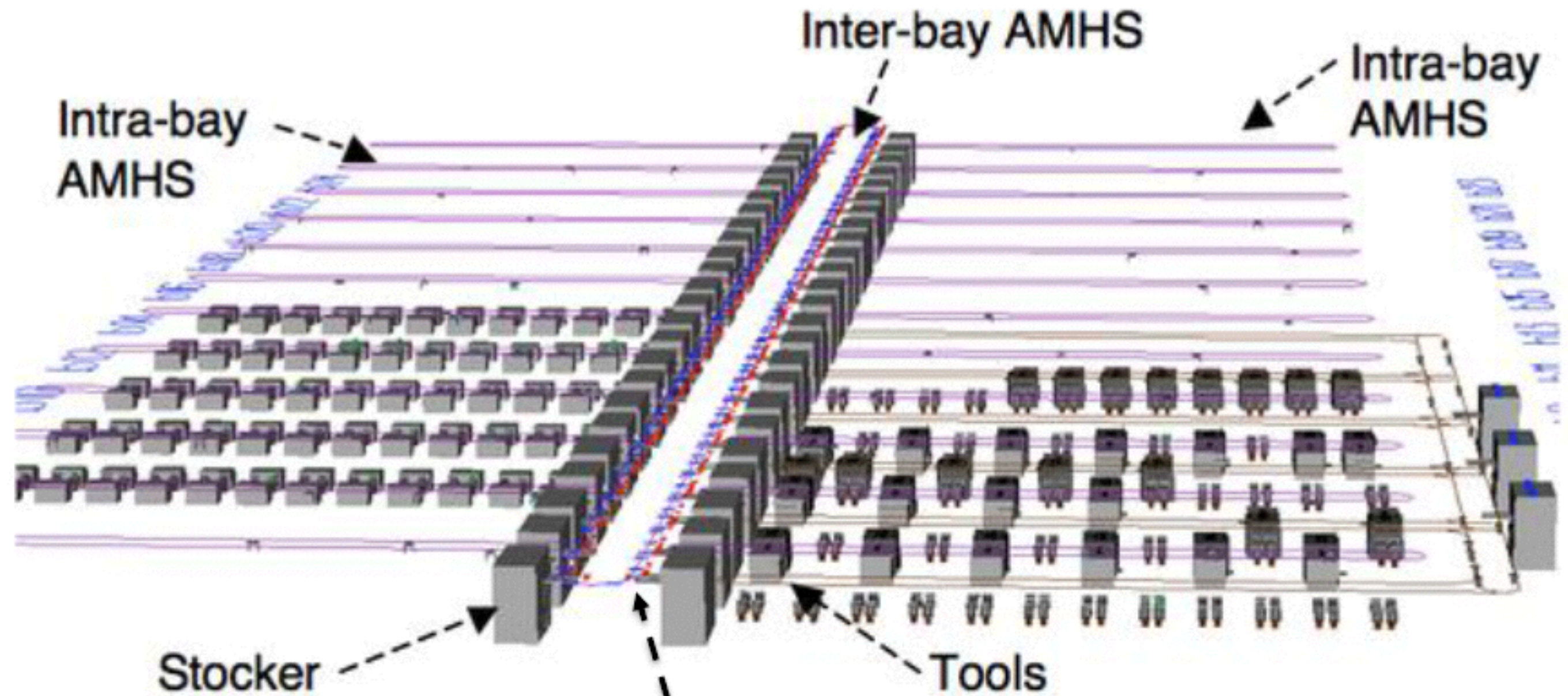
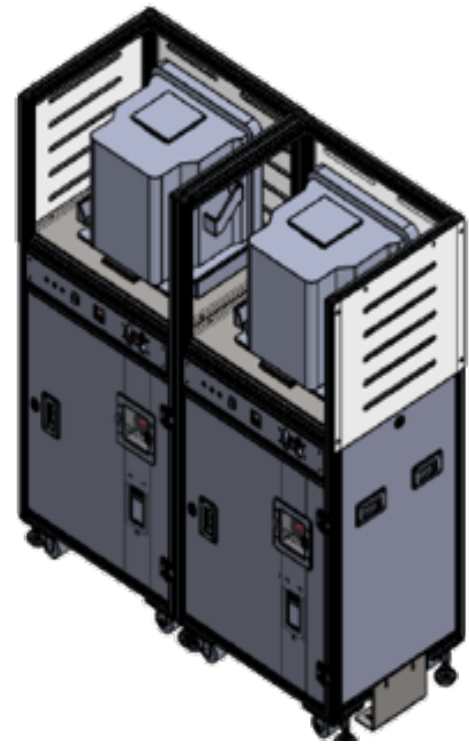
Fab Dispatch Handling System

RFID reader  
RFID antenna  
RFID rack/E-rack



# 晶圓製程AMC防治設備

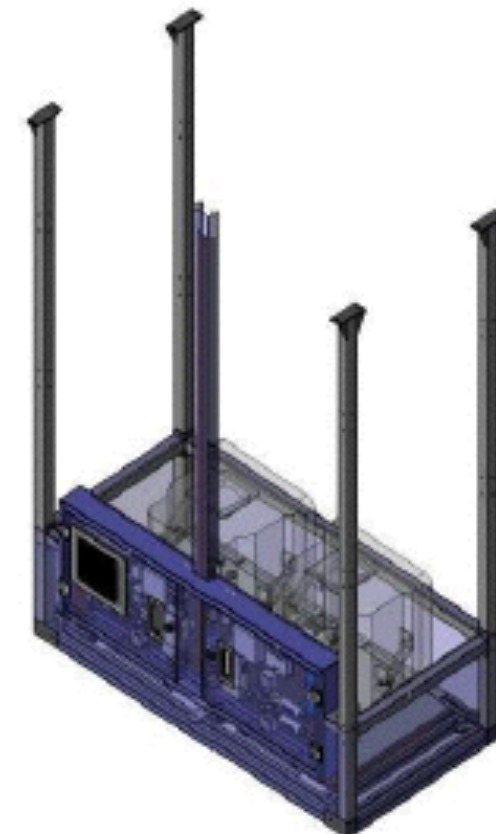
Buffer Station



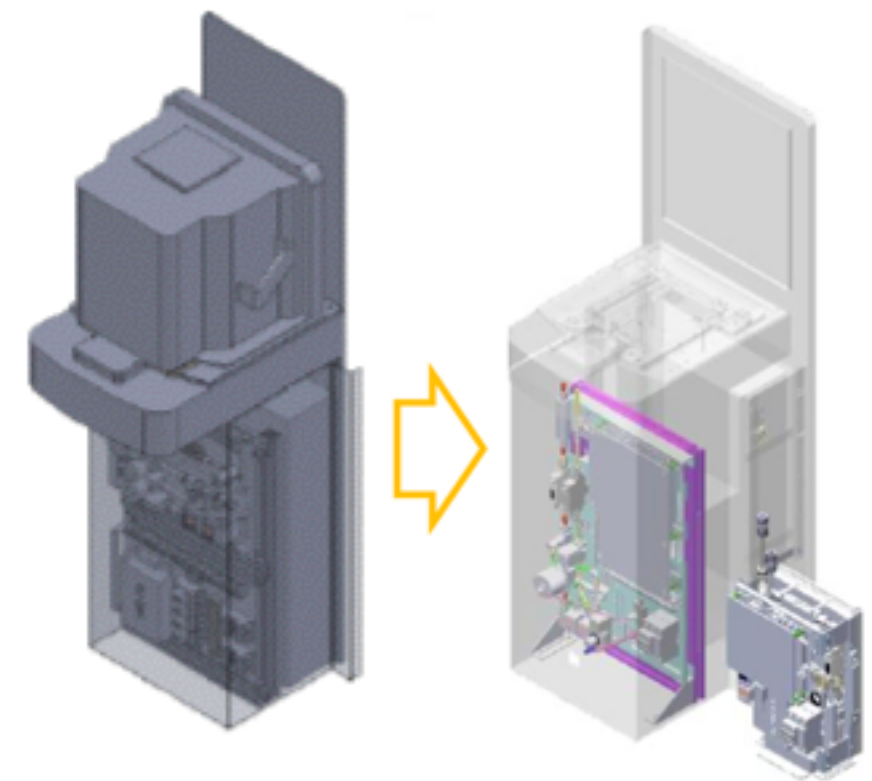
Embedded & Mini-Stocker



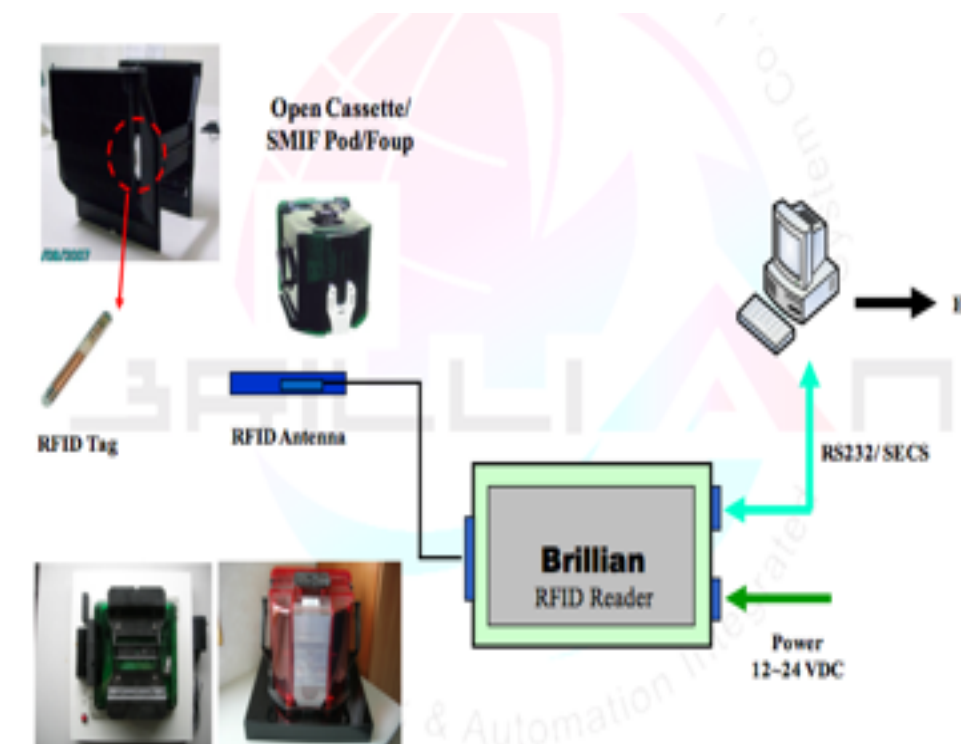
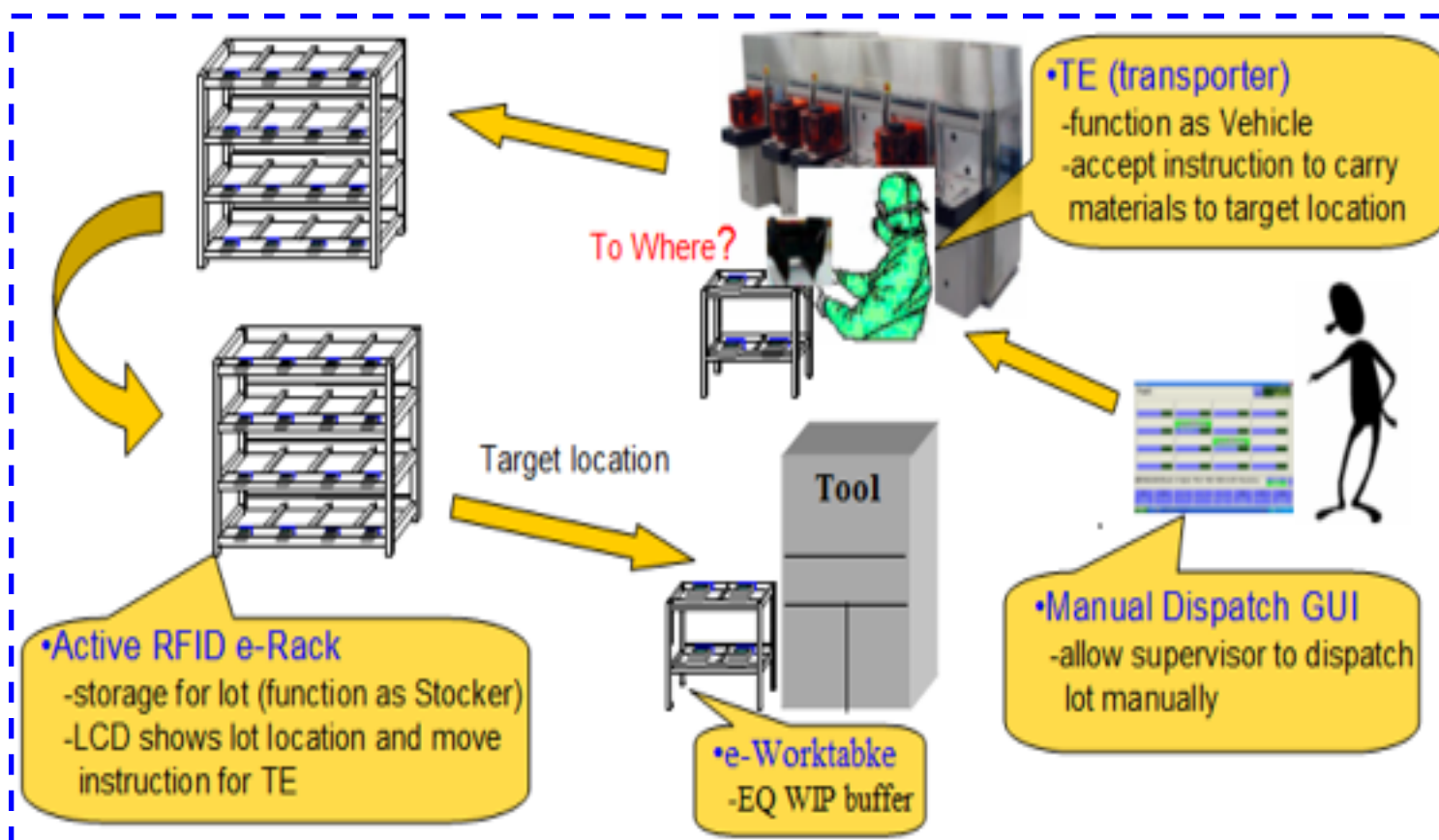
OHB/OHBN2



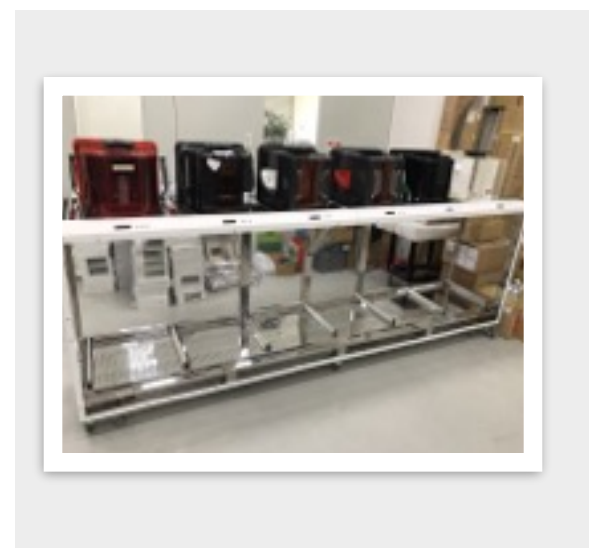
Loadport Purge



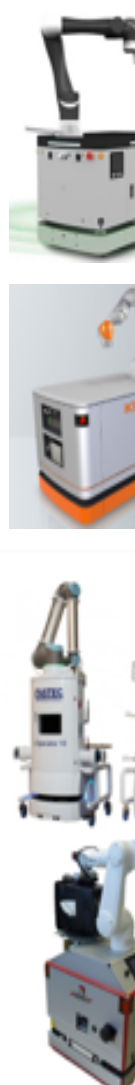
# RFID整合派工系統



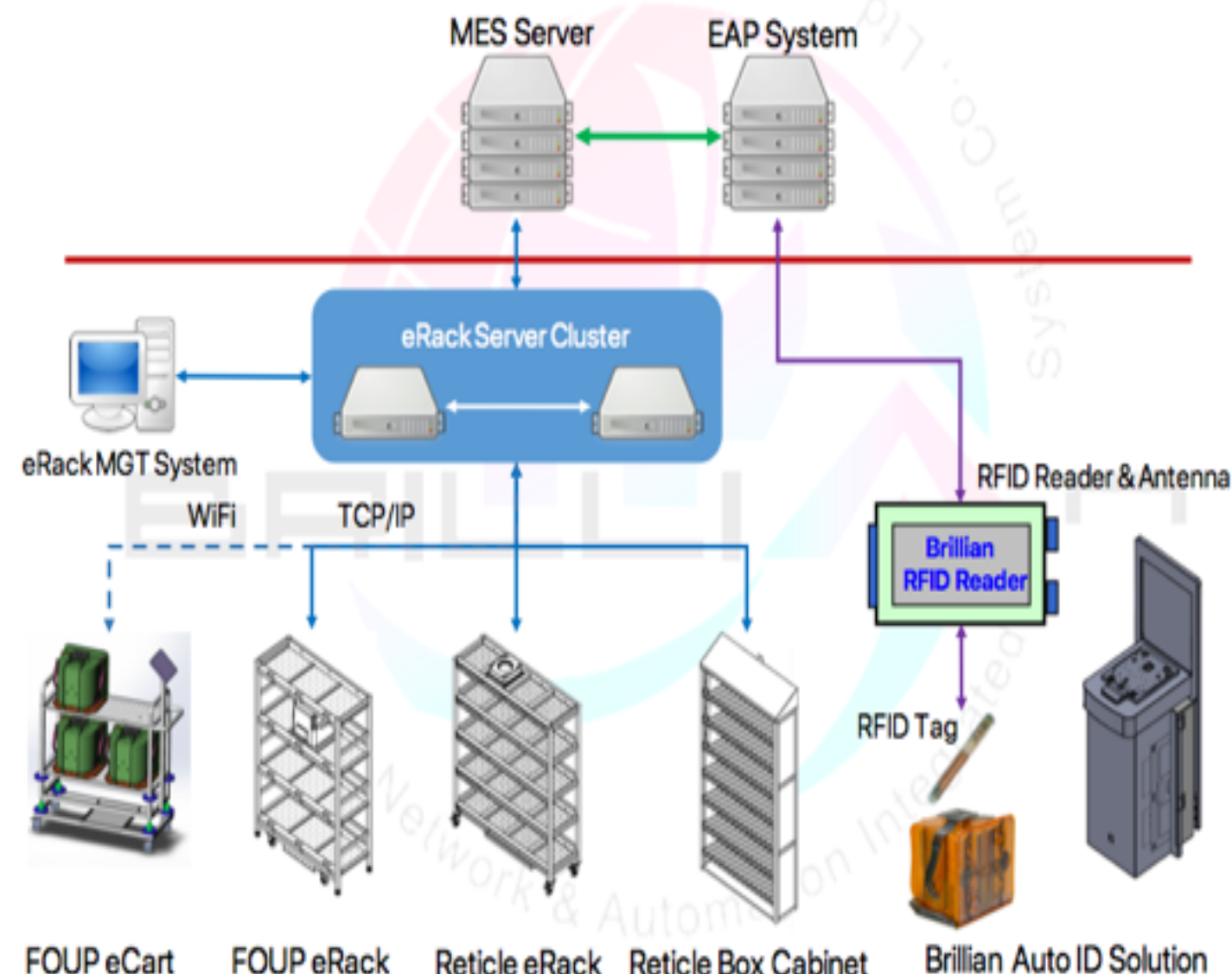
## Mobile Roboter 電子貨架E-RACK



- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Green Trans<br>綠捷 | Fab Bumping<br>12 inch         |
| KUKA<br>上銀科技      | Bumping 12 inch                |
| CASTEC<br>友上科技    | For Reticle POD                |
| 德商<br>Fabmatics   | 12 inch Wafer<br>Level Testing |



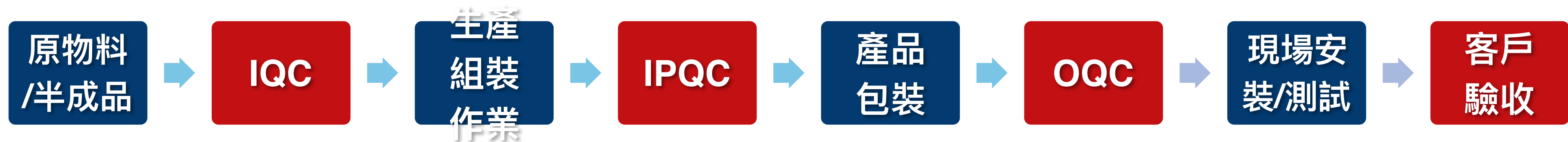
## 電子廠自動化RFID管理派工系統





# 生產流程

## • 生產品質管制流程



ρ 供應商自主檢驗機制

- 物料尺寸、外觀
- 物性/電性功能檢測

ρ 生產組裝製造

- 功能測試
- 燒機測試
- Checklist

ρ 出貨包裝

- 燒機測試
- Checklist

ρ 客戶端現場驗機合格

# Agenda

公司概況

01

02

產品介紹

市場概況

03

04

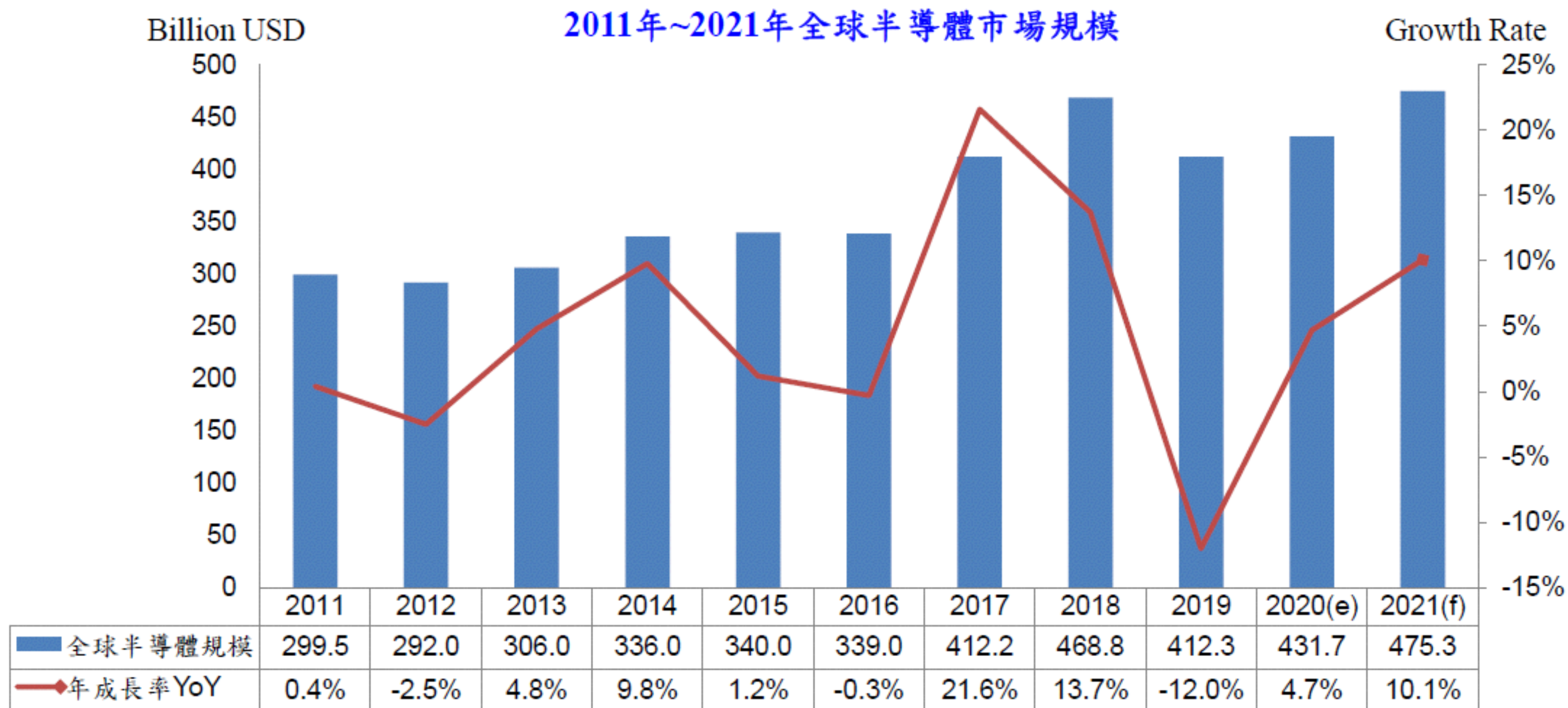
研發技術

經營實績

05



# 半導體市場未來預估



資料來源：WSTS，MIC，2020年9月

- p 2020年雖受新冠肺炎影響，智慧型手機市場及車用市場衰退幅度較大、不過、在遠距需求推升高效運算(HPC)以及筆電需求的帶動下，半導體市場將持續保持成長。
- p 2021年預期HPC以及5G仍為半導體產業成長的雙箭頭，除此之外，物聯網應用也將因為疫情降低接觸的需求催化，而有進一步的成長;但仍需注意疫情若無法獲得有效控制，而產生對於終端消費力道的影響。

# 公司競爭優勢

## 競爭優勢

優良與豐富的  
半導體實績

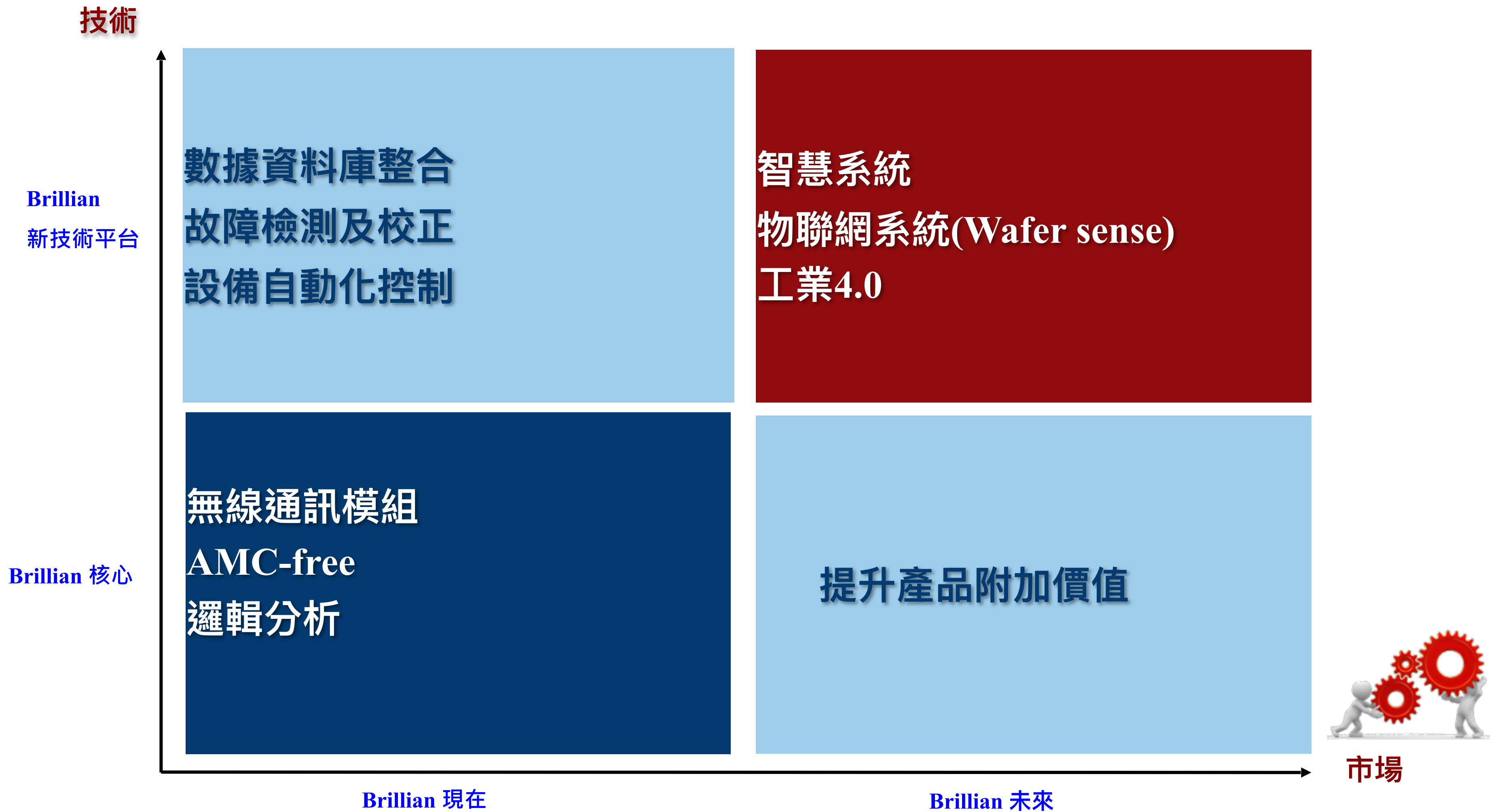
產品自製率高  
及交期迅速

技術創新

專業的工程團  
隊

多項專利佈局

# 成長策略



# Agenda

公司概況

01

02

產品介紹

市場概況

03

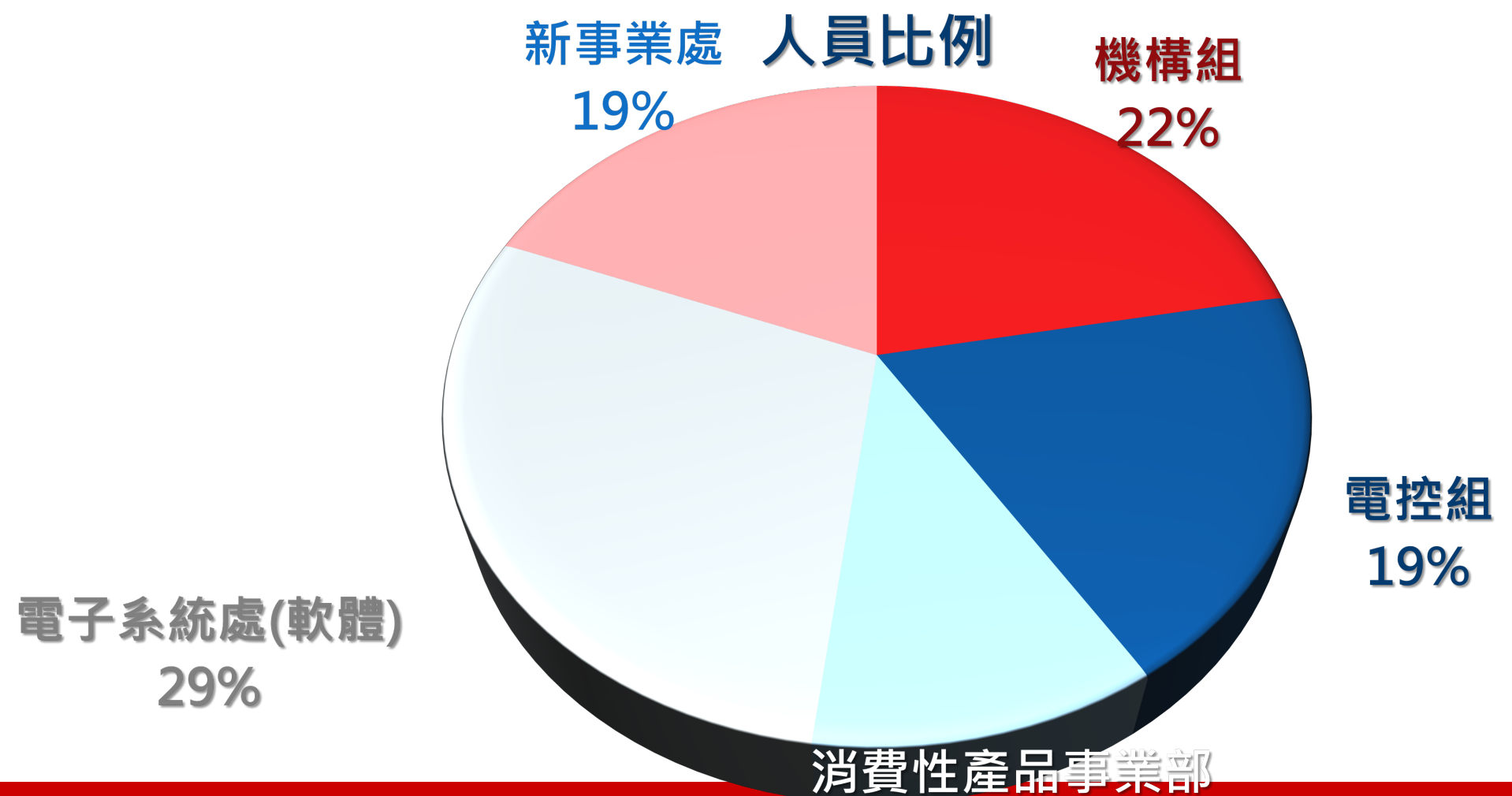
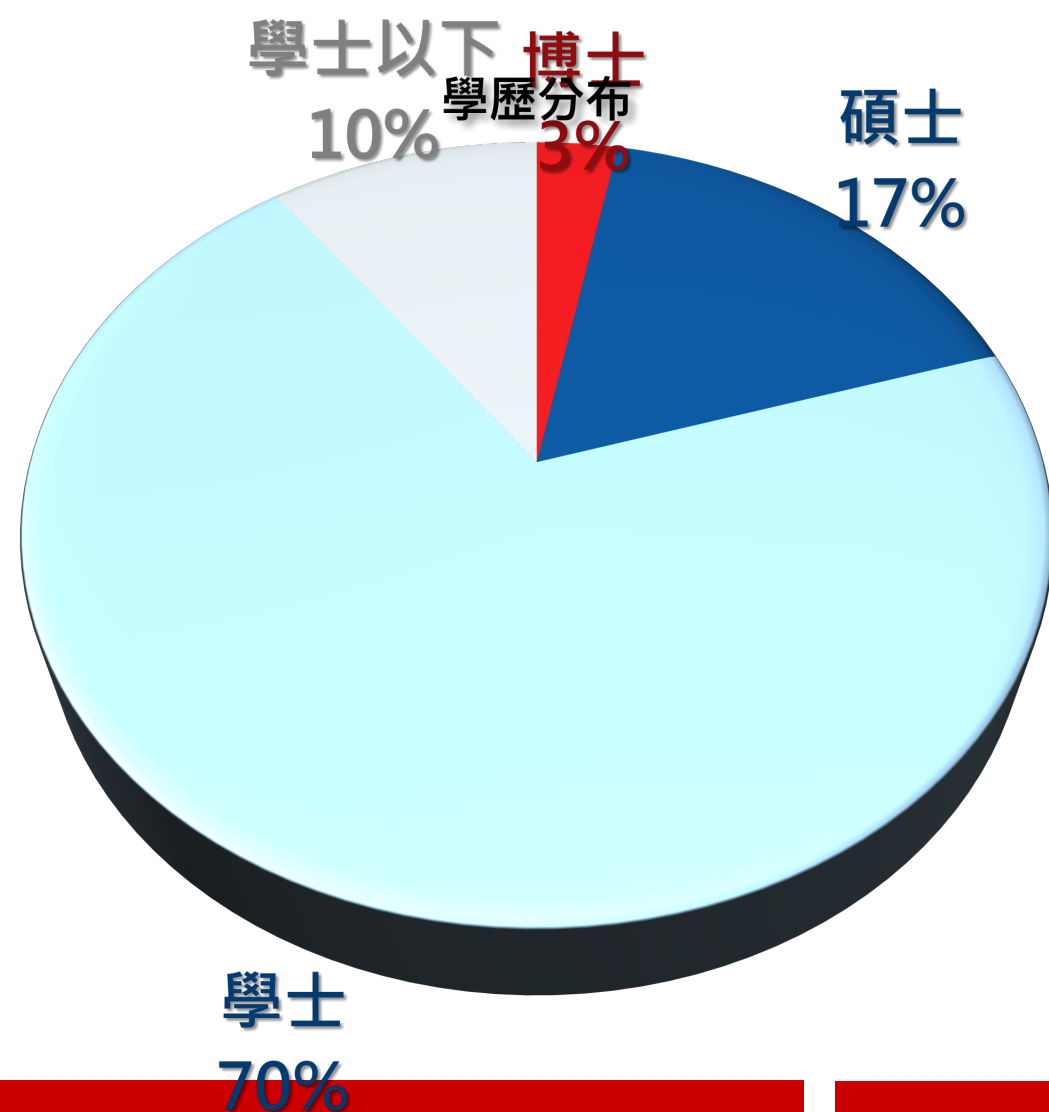
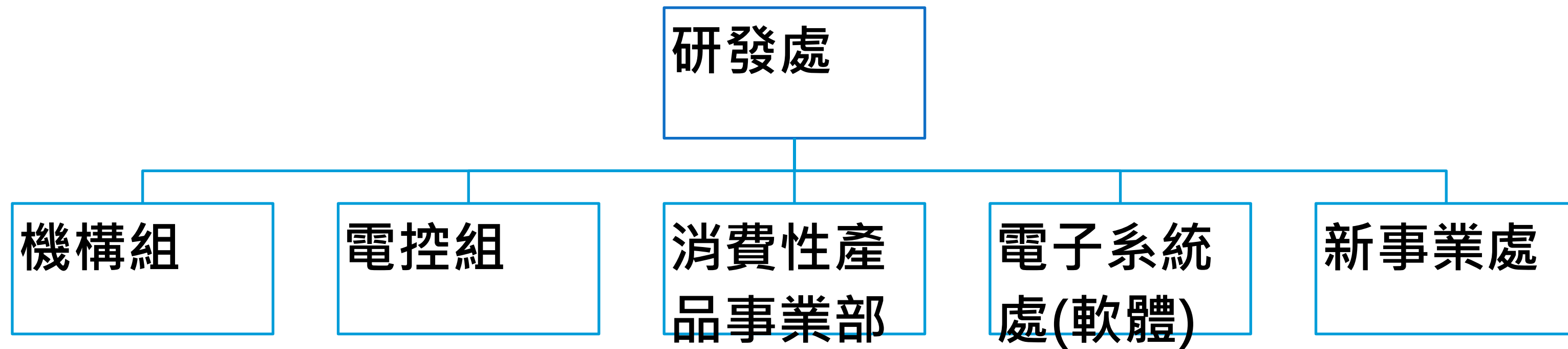
04

研發技術

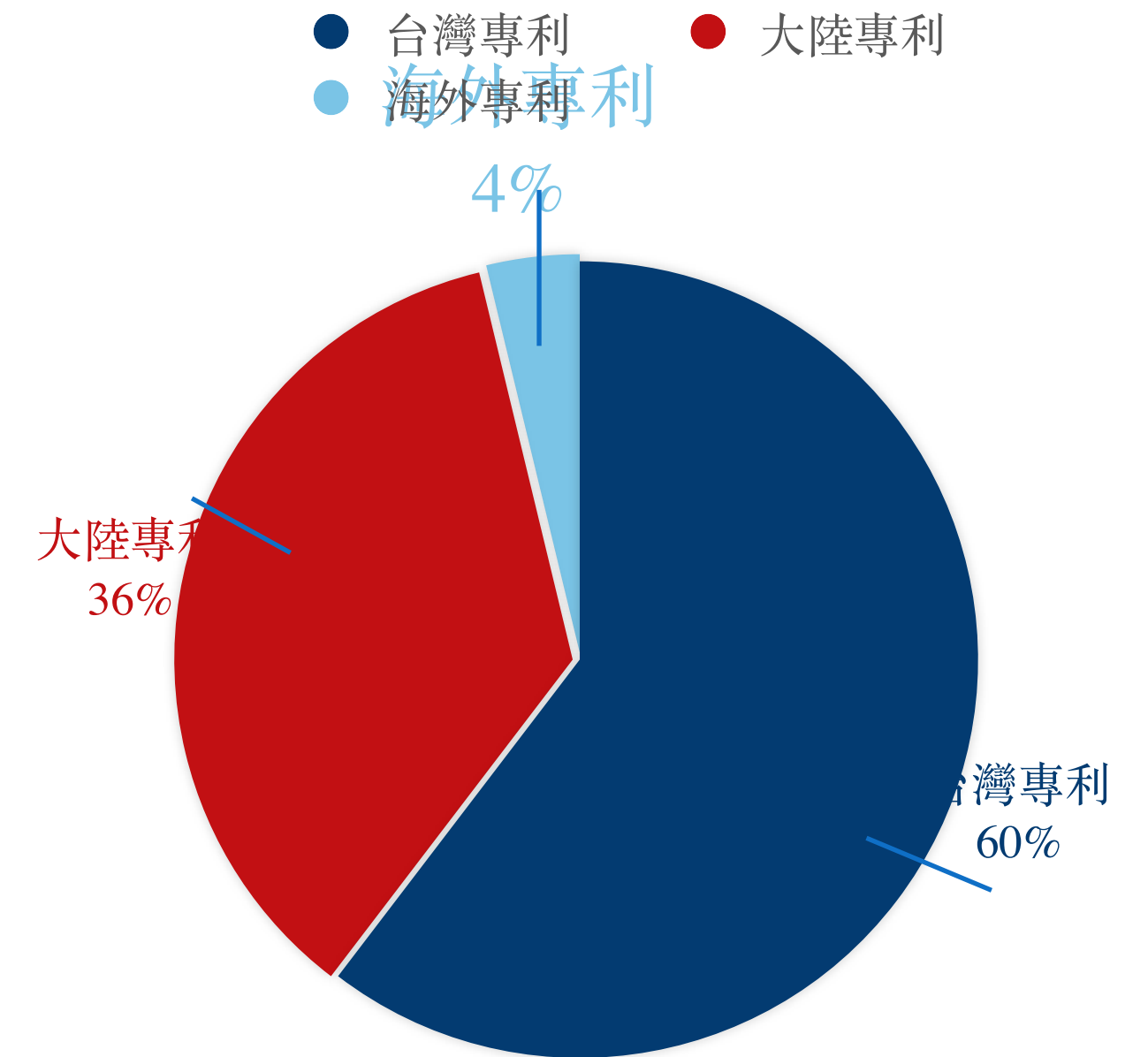
經營實績

05

# 研發能力-組織架構



近年相關專利明細				
項次	專利國別	專利種類	專利名稱	證書號
1	台灣	新型	流場塑形器	M491249
2	台灣/大陸	新型	氣簾裝置及晶圓盒載運設備	M565395
3	台灣/大陸	新型	吹氣裝置及晶圓盒載運設備	M571584
4	台灣/大陸	新型	晶圓載運設備	M572888
5	台灣/大陸	新型	吹氣裝置	M573253
6	台灣	發明	具有吹淨功能的晶圓傳送裝置	I567856
7	台灣	發明	晶圓充氣負載平台的控制方法	I621201
8	美國	發明	PURGE LOAD PORT	<a href="#">US20170069516A1</a>
9	德國	發明	Beladungsöffnungsanschluss mit Spülfunktion	<a href="#">DE102015115932A1</a>
10	大陸	發明	晶圓充氣負載平臺的控制方法 Control method of wafer inflation loading platform	<a href="#">CN109298737A</a>
11	台灣/大陸	新型	晶圓盒氣體交換設備	<a href="#">M551749</a>
12	台灣/大陸	新型	充氣系統	M555557
13	台灣/大陸	新型	晶圓盒載運系統	M556017
14	台灣/大陸	新型	晶圓盒承載裝置	M558466
15	台灣/大陸	新型	氣嘴組件及晶圓盒承載裝置	M561910
16	台灣/大陸	新型	氣體切換系統	M561910
17	台灣/大陸	新型	晶圓盒載運裝置及晶圓盒載運設備	M5720



# Agenda

公司概況

01

02

產品介紹

市場概況

03

04

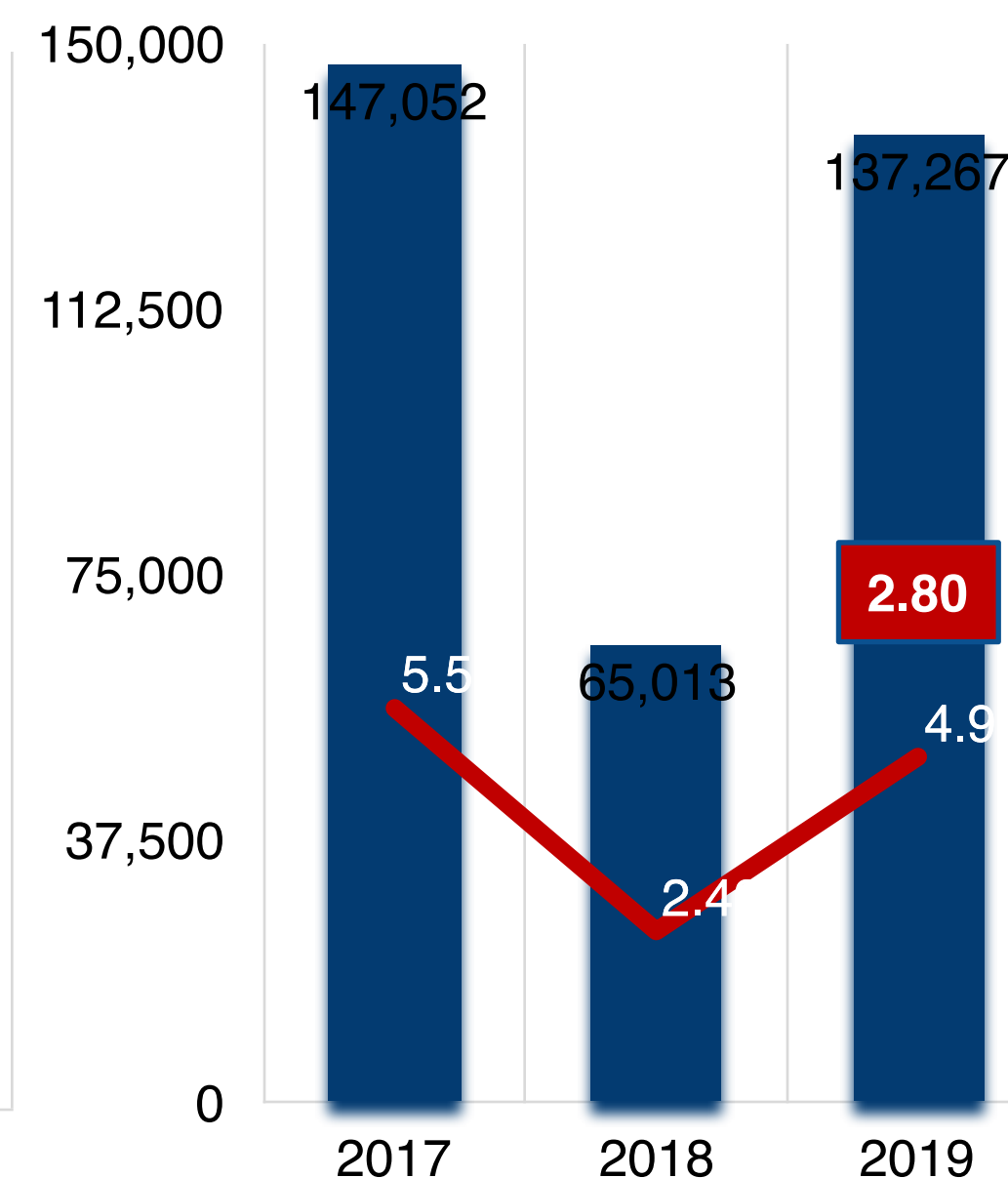
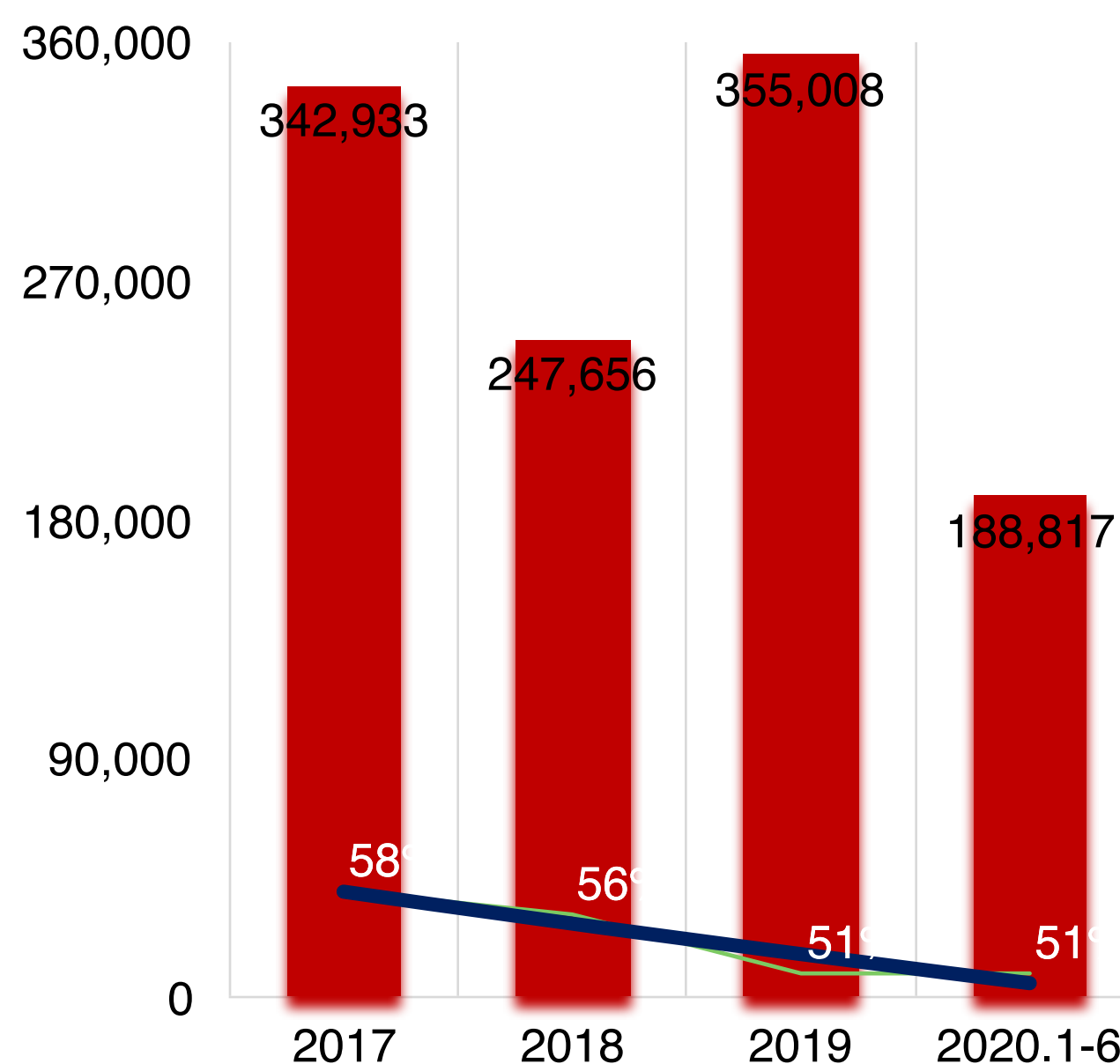
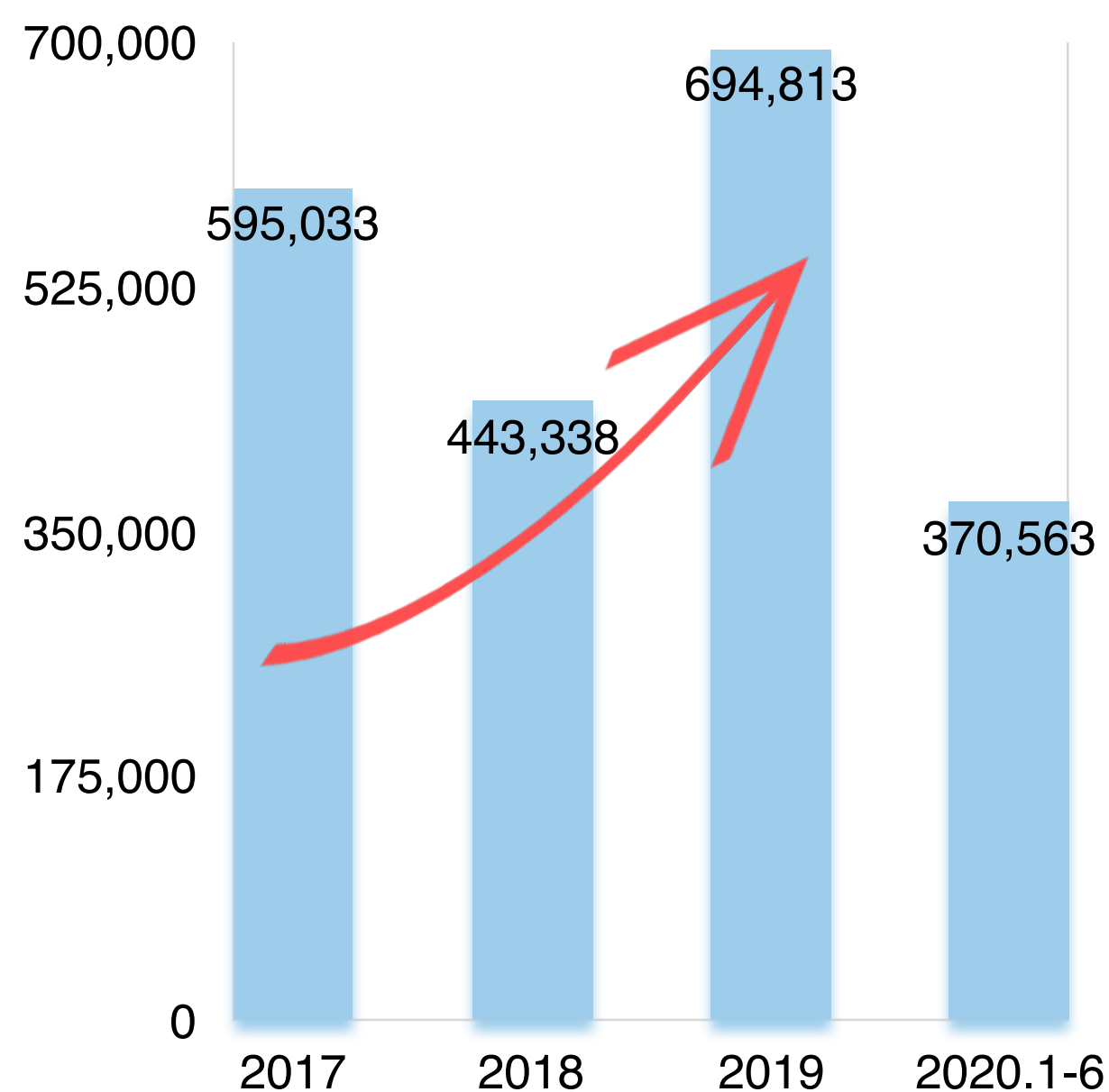
研發技術

經營實績

05

# 財務績效

單位:新台幣仟元



■ 2017  
■ 2018  
■ 2019  
■ 2020.1-6

■ 營業毛利    — 毛利率    — 毛利率

■ 稅後淨利    — EPS



# 財務績效



## 損益表

單位：新台幣千元

年度	2017年度	%	2018年度	%	2019年度	%	2020.1~6月	%
營業收入	595,033	100	443,338	100	694,813	100	370,563	100
營業毛利	342,933	58	247,656	56	355,008	51	188,817	51
營業利益	176,190	30	82,401	19	169,992	24	103,056	28
營業外收支	7,687	1	6,305	1	4,158	1	556	-
本期淨利	147,052	25	65,013	14	137,267	20	84,246	23
綜合損益總額	143,961	24	63,596	14	133,133	19	81,744	22
每股盈餘(元)	5.59		2.43		4.90		2.80	

資料來源：上述各年度財務資料均經會計師查核(核閱)簽證。

## 資產負債表

單位：新台幣千元

年度	2017.12.31	2018.12.31	2019.12.31	2020.06.30
現金及約當現金	333,851	285,826	329,744	376,804
應收票據及帳款	106,427	110,945	185,075	104,684
存貨	112,496	109,457	173,519	190,319
資產總額	722,090	678,201	887,038	885,351
負債總額	188,339	167,579	248,032	208,213
權益總額	533,751	510,622	639,006	677,138

資料來源：上述各年度財務資料均經會計師查核(核閱)簽證。

# Brilliant Innovation



致力於改善客戶整體生產力  
是客戶提升生產力的最佳夥伴



# 謝謝聆聽與指教